

14.03.2024 – 10:58 Uhr

ERS electronic stellt die erste halbautomatische Maschine der Luminex-Produktlinie mit der bahnbrechenden PhotoThermal-Debonding-Technologie vor

München, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -

ERS electronic, der branchenführende Anbieter von Wärmemanagementlösungen für die Halbleiterfertigung, stellt die erste Maschine aus seiner innovativen Luminex-Produktlinie vor, die mit der hochmodernen „PhotoThermal“-Debonding-Technologie für Wafer und Panels bis 600 x 600 mm ausgestattet ist.

Beim photothermischen Debonding handelt es sich um eine spannungsfreie Debonding-Methode, bei der der Träger mit Hilfe einer hochgradig kontrollierten Blitzlampe vom Substrat getrennt wird. Eine Schlüsselkomponente des PhotoThermal Debonding-Prozesses ist der Glasträger mit lichtabsorbierender Schicht (CLAL), der die Lichtenergie der Lampe in Wärmeenergie umwandelt und so eine reibungslose Trennung ermöglicht. Dank CLAL entfällt die zusätzliche Beschichtung der Klebstofftrennschicht zusammen mit der Bondschicht, wodurch sich die Prozessschritte und die damit verbundene Komplexität und die Betriebskosten verringern und die Anwender im Vergleich zum herkömmlichen Laser-Debonding bis zu 30 % der Betriebskosten sparen.

Die halbautomatische Maschine von ERS ist die erste einer Reihe von Maschinen, die zur Luminex-Produktlinie gehören. ERS befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung seines vollautomatischen Gegenstücks für 300-mm-Wafer, das noch vor Ende des zweiten Quartals auf den Markt kommen wird. Als Teil der umfassenden Produktlinie wird das Unternehmen den Automaten mit mehreren modularen Zusatzausstattungen anbieten, um die Produktqualität und den Ertrag weiter zu verbessern.

„PhotoThermal Debonding stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Halbleiterfertigung dar“, sagt Debbie-Claire Sanchez, Vice President and Head der APEqS Business Unit bei ERS. „Die erste Maschine unserer Luminex-Linie ist ein großartiges Sprungbrett für Forschungs- und Entwicklungsteams, die an fortschrittlichen Verpackungsentwicklungen oder der Einführung neuer Produkte arbeiten, und wir laden Unternehmen ein, uns ihre Muster zum Testen zu schicken.“

Ab April wird die halbautomatische Maschine im ERS-Labor in Shanghai, China, und in Deutschland eingesetzt, wo sie zur Prüfung von Wafer- und Panelmustern von Kunden verwendet wird und für Vorführungen zur Verfügung steht.

Informationen zu ERS:

Die ERS electronic GmbH mit Sitz im Münchner Vorort Germering bietet seit mehr als 50 Jahren innovative Wärmemanagement-Lösungen für die Halbleiterindustrie. Einen hervorragenden Ruf hat sich das Unternehmen vor allem mit seinen schnellen und präzisen luftgekühlten thermischen Spannsystemen für Prüftemperaturen von -65 °C bis +550 °C für analytische, parameterbezogene und fertigungstechnische Untersuchungen erworben. Im Jahr 2008 hat ERS sein Know-how auf den Markt für Advanced Packaging ausgeweitet. Heute sind ihre vollautomatischen und manuellen Systeme zur Entklebung und Verzugsregulierung in den Produktionshallen der meisten Halbleiterhersteller und OSATs weltweit zu finden. Das Unternehmen hat in der Branche breite Anerkennung für seine Fähigkeit erhalten, komplexe Verzugsprobleme zu lösen, die bei der Herstellung von Fan-out-Wafer-Level-Packaging auftreten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2361259/Luminex_Photothermal.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2276058/ERS_Logo.jpg

View original content: <https://www.prnewswire.com/news-releases/ers-electronic-stellt-die-erste-halbautomatische-maschine-der-luminex-produktlinie-mit-der-bahnbrechenden-photothermal-debonding-technologie-vor-302089245.html>

Pressekontakt:

Sophia Oldeide,

oldeide@ers-gmbh.de,
+49 8989 4132-143

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100089895/100916976> abgerufen werden.